

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(21) आवेदन सं. 6847/डीईएलएनपी/2013 ए

(19) भारत

(22) आवेदन फ़ाइल करने की तिथि : 31/07/2013

(43) प्रकाशन की तिथि : 23/01/2015

(54) खोज का शीर्षक : फ्लिप चिप बॉल गिड आरेज के लिए वैकल्पिक सरफेस फिनिश

(51) अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण :H01L23/498
(31) प्राथमिकता दस्तावेज़ सं :12/986584
(32) प्राथमिकता तिथि :07/01/2011
(33) प्राथमिकता देश का नाम :यू.एस.ए. (अमेरिका).
(86) अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं. :PCT/US2012/020464
फ़ाइल करने की तिथि :06/01/2012
:WO 2012/094582
(87) अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सं :लागू नहीं
(61) आवेदन सं. में जोड़ने का पेटेंट :लागू नहीं
फ़ाइल करने की तिथि :लागू नहीं
(62) आवेदन सं. में विभाजन संबंधी :लागू नहीं
फ़ाइल करने की तिथि

(71) आवेदक का नाम :

1) एटीआई टेक्नोलॉजीज यूएलसी

आवेदक का पता : वन कॉमर्स वेली ड्राइव ई.
मार्खम ऑटोरियो एल3टी 7एक्स6 कनाडा

(72) खोजकर्ता का नाम :

1) लियंग एंड्यू के.

2) मैक्लेलन नील

(57) सारांश :

एक बॉल गिड आरे पैकेज डिवाइस में एक सबस्ट्रेट सम्मिलित है जहां सबस्ट्रेट पर एक कॉपर बॉल गिड आरे पैड बना हुआ है। कॉपर पैड पर एक निकेल लेयर बनाया जा सकता है और निकेल लेयर पर एक टिन लेयर बनाया जा सकता है। निकेल लेयर एक इलेक्ट्रोलेस निकेल प्लेटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है। टिन लेयर एक इमर्सन टिन प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कुछ मामलों में टिन के स्थान पर सिल्वर का उपयोग किया जा सकता है और इसे एक इमर्सन सिल्वर प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है।

पृष्ठों की सं.: 11

दावों की सं.: 21